

2019



» 矢志发展
步履始终向前

» 2005年
改制
河南新乡神舟晶体
第二代半导体材料研发与生产

» 2010年
升级
北京世纪金光
第三代半导体产业化

» 2016年
第一款SiC MOSFET器件研发成功；
第一款GaN HEMT器件研发成功；
承担了第一个“军民融合SiC三端器件”
国家重大专项任务；
收购首钢微电子有限公司器件前道工艺生产
线；
启动GaN全产业链工业生产线上全面建设；
成立员工持股平台



» 1970年
始建
中原半导体研究所
第一代半导体材料研发与生产

» 2008年
转型
北京华进创威
第三代半导体材料研发与生产

» 2015年
完成第一次股改；
第一款SiC SBD研制成功；
开始SiC全产业链工业生
产线建设。

» 2017年
国家半导体产业发展基金投资
“世纪金光”；
实现第二轮股改；
“企业研发中心”被开发区评为
“北京经济技术开发区研发机材
获批“第三代半导体功率器件设
计与验证北京市工程实验室”。
SiC从粉料到功率器件产业链建
并投产；





